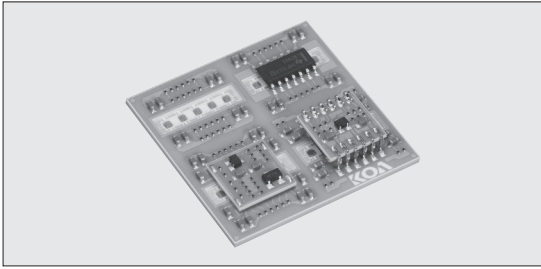
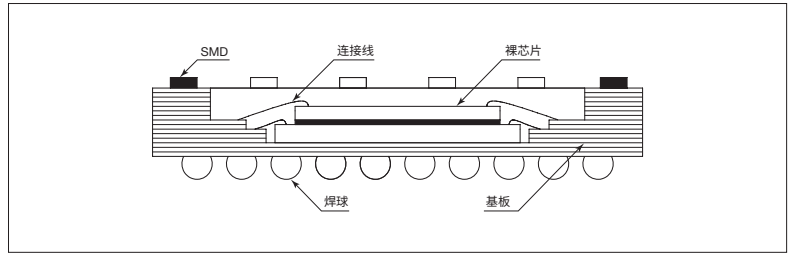


KLCJ 定制模块



■ 结构图



■ 特点

- 由复数个半导体编入一个封装，实现系统的小型化，高功能化，标准化。
- LTCC基板的多层精巧焊盘，使得线路面积的降低、配线距离缩短，因此能解除信号延迟的问题
- 减少外部端子，降低贴装不良率

■ 贴片规格

项目	单位	minimum	Standard	Maximum	Note
基板外形尺寸	mm	—	—	100×100	
基板厚度	mm	0.4	—	2.0	
裸芯片管脚间距	μm	100	—	—	
裸芯片管脚尺寸	μm	70	—	—	
裸芯片管脚厚度	mm	0.1	0.2	—	
封装高度	mm	0.3	1.0	1.2	芯片表面开始的高度
线长	mm	0.3	—	3.0	
线环高度	μm	100	200	—	
线径	Au μm	20	25	40	
基板表面处理	无电解镀金				
基板	• LTCC				

■ 封装规格

项目	内容
端子节距	0.8mm~
可焊接产品	• SMD • 裸芯片 • 印刷电阻
可对应封装	• SON • BGA • LGA
封装基材	• LTCC

■ 树脂密封

灌封材料	颜色	Note
环氧树脂	黑	

